

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 6 月 20 日 (2019.6.20)

【公開番号】特開 2018-22813 (P2018-22813A)

【公開日】平成 30 年 2 月 8 日 (2018.2.8)

【年通号数】公開・登録公報 2018-005

【出願番号】特願 2016-154213 (P2016-154213)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/66 B

H 0 1 L 21/68 A

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 5 月 14 日 (2019.5.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

搬送エリアとメンテナンスエリアとの間に配置された複数の測定部であって、ウエハ上に形成された半導体素子の検査の際に用いられる被メンテナンス装置と、前記被メンテナンス装置を前記メンテナンスエリア側に引き出す引出機構と、を備えた複数の測定部と、前記測定部と一定距離隔てて設けられ、搬送物を収納する搬送物収納部と、
前記搬送物を前記搬送物収納部から取り出して、前記搬送物を前記搬送先の測定部内に
搬送する搬送ユニットと、を備え、

前記被メンテナンス装置の引出方向と前記搬送物の搬送方向とが同じ方向であり、
前記被メンテナンス装置は、テストヘッドであるプローバ。

【請求項 2】

前記搬送物はウエハないしはプローバカードである請求項 1 に記載のプローバ。